

天津金海通半导体设备股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东崔学峰先生持有公司股份 8,511,132 股，占公司总股本比例为 14.19%，本次质押 1,130,000 股后，崔学峰先生累计质押数量为 3,165,000 股，占其持股数量比例为 37.19%，占公司总股本比例为 5.28%。

● 截至本公告披露日，崔学峰先生及其一致行动人龙波先生持有公司股份 13,855,278 股，占公司总股本比例为 23.09%。截至本公告披露日，崔学峰先生及其一致行动人累计质押数量为 3,695,000 股（含本次），占其合计持股数量比例为 26.67%，占公司总股本比例为 6.16%。

公司于近日获悉，公司股东崔学峰先生将所持有本公司的部分股份质押，作为对前期股份质押 2,035,000 股的补充质押，具体情况如下：

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次补充股数（股）	是否为限售股（如是，注明限售类型）	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	质押融资资金用途
崔学峰	是	1,130,000	首发限售股	是	2024年7月26日	2026年5月28日	海通证券股份有限公司	13.28	1.88	补充质押
合计	/	1,130,000	/	/	/	/	/	13.28	1.88	/

（注：以上数据如果有误差，为四舍五入所致。）

2、上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他

保障用途的情形。

3、控股股东及其一致行动人累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
崔学峰	8,511,132	14.19	2,035,000	3,165,000	37.19	5.28	3,165,000	0	5,346,132	0
龙波	5,344,146	8.91	530,000	530,000	9.92	0.88	530,000	0	4,814,146	0
合计	13,855,278	23.09	2,565,000	3,695,000	26.67	6.16	3,695,000	0	10,160,278	0

(注：以上数据如果有误差，为四舍五入所致。)

本次质押主要用于股票质押式回购交易补充质押，不涉及新增融资安排。崔学峰先生资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。上述质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照规定，依法及时履行信息披露义务。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2024年7月30日